

## 通富微电

成立于1997年，国内集成电路封装测试领域佼佼者，2007年于深圳证券交易所上市，专业从事集成电路封装测试的高新技术企业

### 品牌简介

通富微电子股份有限公司成立于1997年10月，2007年8月在深圳证券交易所上市（股票简称：通富微电，股票代码：002156）。公司总股本115370万股，第一大股东南通华达微电子集团有限公司（占股28.35%）、第二大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（占股21.72%），总资产160多亿元。

通富微电专业从事集成电路封装测试，总部位于江苏南通，拥有崇川总部工厂、南通通富微电子有限公司（南通通富）、合肥通富微电子有限公司（合肥通富）、厦门通富微电子有限公司（厦门通富）、苏州通富超威半导体有限公司（TF-AMD苏州）、TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.（TF-AMD槟城）六大生产基地。通过自身发展与并购，公司已成为本土半导体跨国集团公司、中国集成电路封装测试领军企业，集团员工总数超1.3万人。

通富微电是国家科技重大专项（“02”专项）骨干承担单位，拥有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省级工程技术研究中心以及先进信息技术研究院等高层次研发平台，拥有2000多人的技术管理团队。

通富微电在行业内较早通过ISO9001、ISO/TS16949等质量体系。采用SAP、MES、设备自动化、EDI等信息系统，可按照客户个性化的规范自动控制生产过程，实时和客户进行信息交互。实施“通富微电工业4.0”项

目，构建以物联网为基础的智慧工厂，建立柔性自动化流水线，与客户实现共赢。

通富微电的发展目标，是要成为世界的集成电路封测企业。在国家政策支持 and 市场拉动下，在系统厂家的需求牵引、产业链的协同发展、国家产业基金和国家重大专项的支持下，通富微电将不断向着国际集成电路封测企业的目标迈进。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/tfwd-928512.html>